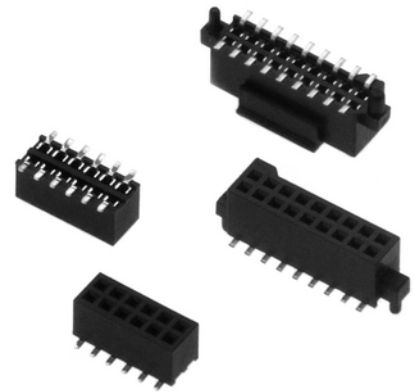


## SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig - BH 3,6/4,5mm SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row - 3.6/4.5mm Profile

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

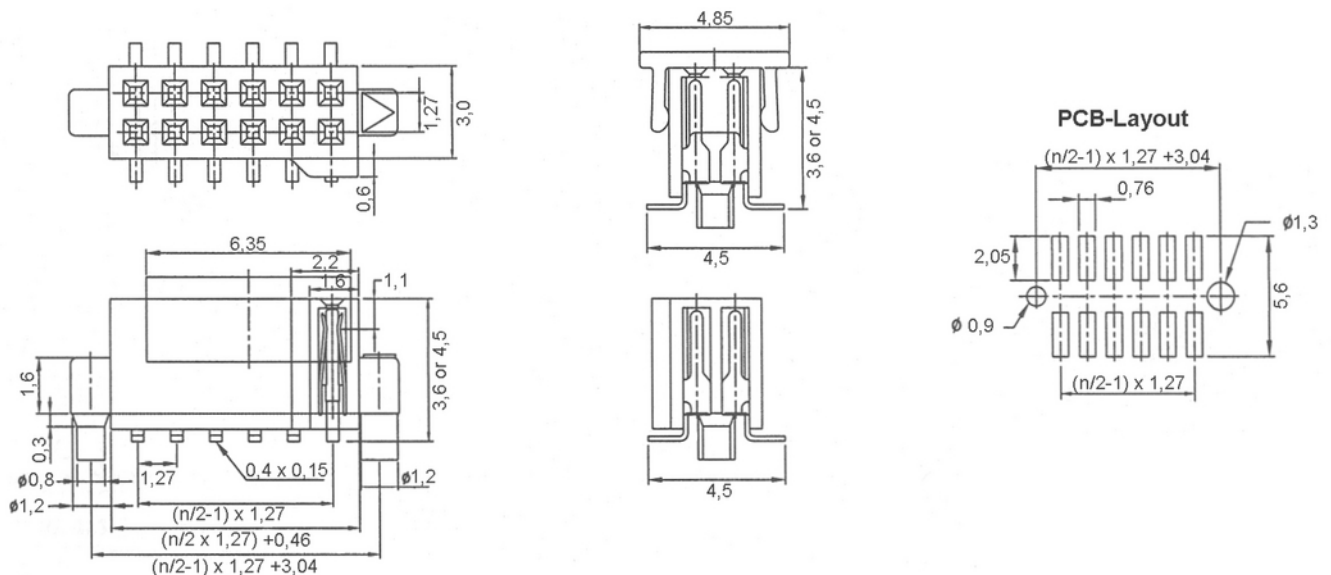


© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte  
0,40mm / Dual beam contacts accept square  
pins 0.40mm.

Passende Stiftleisten Serien / Mate with Pin  
Header Series:

**6110** (nur BH 4,5mm / only 4.5mm Profile)  
**7072 7073 7075**



Series	Contacts*	Profile*	Plating*	Locating Peg*	Polarisation Key*	Packaging*
<b>6060</b>	<b>040</b> 006-100 Zweireihig Double row	<b>46</b> 36 Bauhöhe 3,60mm Height 3.60mm 46 Bauhöhe 4,50mm Height 4.50mm	<b>00</b> Vergoldet Gold plated <b>50</b> Verzinkt Tin plated	<b>10</b> Ohne Pos.hilfe W/o loc. peg <b>10</b> Mit Pos.hilfe With loc. peg	<b>10</b> Ohne Pol.hilfe W/o pol. key <b>10</b> Mit Pol.hilfe With pol. key	<b>PPST</b> ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packing Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperature $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

